

2009 年度版日本実装技術ロードマップ 目次

序文

日本実装技術ロードマップ執筆者名簿

目次

第1章 総則

- 1.1 はじめに
- 1.2 2009 年度版の活動課題と今後の対応

第2章 電子機器の動向

- 2-1 電子機器の分類と定義
- 2-2 携帯電話
- 2-3 ウエアラブル機器
- 2-4 モバイルデジタルイメージング AV 機器
- 2-5 ホームデジタル AV 機器
- 2-6 ノート PC
- 2-7 カーナビゲーション/PND
- 2-8 カーエレクトロニクス
 - 2-8-1 エンジンルーム外に搭載される電子機器ユニット
 - 2-8-2 エンジンルーム内に搭載される電子機器ユニット
- 2-9 実装設備への要求
- 2-10 環境対応
- 2-11 ディフィカルトチャレンジ
 - 2-11-1 電子機器からの要求のまとめ
 - 2-11-2 微小部品と大型部品の混載実装の実現に向けて
 - 2-11-3 まとめ

第3章 部品・実装設備の動向

- 3.1 半導体デバイス
 - 3.1.1 はじめに
 - 3.1.2 デバイス技術動向
 - 3.1.3 各種パッケージ技術動向
 - 3.1.4 パッケージ組立プロセス技術動向
 - 3.1.5 ベアチップと WL-CSP
 - 3.1.6 SiP
 - 3.1.7 特殊パッケージ
 - 3.1.8 パッケージ基板
 - 3.1.9 放熱設計
 - 3.1.10 環境対応
 - 3.1.11 ITRS (国際半導体ロードマップ) との比較
 - 3.1.12 ディフィカルトチャレンジ
 - 3.1.13 まとめ
- 3.2 電子部品
 - 3.2.1 インダクタ
 - 3.2.2 コンデンサ

- 3.2.3 抵抗器
- 3.2.4 EMC 部品
- 3.2.5 コネクタ
- 3.2.6 高周波モジュール
- 3.2.7 入出力デバイス
- 3.2.8 半導体セラミックス
- 3.3 プリント配線板技術ロードマップの総論
 - 3.3.1 プリント配線板
 - 3.3.2 ビルドアップ多層配線板
 - 3.3.3 多層プリント配線板
 - 3.3.4 両面プリント配線板
 - 3.3.5 片面プリント配線板
 - 3.3.6 多層フレキシブルプリント配線板
 - 3.3.7 両面 FPC
 - 3.3.8 片面 FPC
 - 3.3.9 TAB/COF
 - 3.3.10 テープ構造サブストレート
 - 3.3.11 リジッド構造サブストレート
 - 3.3.12 ビルドアップ構造サブストレート
 - 3.3.13 セラミック構造サブストレート
 - 3.3.14 共通事項
 - 3.3.15 ディフィカルトチャレンジ
- 3.4 実装設備
 - 3.4.1 はじめに
 - 3.4.2 生産性の動向
 - 3.4.3 実装設備に対する要求経過と今後の動向
 - 3.4.4 実装技術動向
 - 3.4.5 次世代実装への対応
 - 3.4.6 ディフィカルトチャレンジ
 - 3.4.7 トピックス

第4章 トピックス：実装事業構造研究会報告

Appendix 1 日本実装技術ロードマップで採用されている用語

- 1.1 用語の定義
- 1.2 日本実装技術ロードマップ関連英文略号一覧

Appendix 2 実装技術ロードマップ活動報告・委員名簿

- 2.1 実装技術ロードマップ活動報告
- 2.2 Jisso 戦略専門委員会/実装技術ロードマップ G 名簿